

博众星威系列全自动高精度贴片设备助力半导体后道工艺

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 博众星威系列全自动高精度贴片设备助力半导体后道工艺 |
| 公司名称 | 苏州博众半导体有限公司 |
| 价格 | 400000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:博众半导体 型号:EF9721 产地:江苏省苏州市 |
| 公司地址 | 苏州市吴江区江陵街道庞山路西侧（东运科技园8#厂房）（注册地址） |
| 联系电话 | 0512-63414949 18021462023 |

产品详情

EH9721贴片机拥有轨道接驳上下料等功能，应用产品更广泛，更适用于批量化的产品生产。

产品特点：

- 1.高精度：±2m@3
- 2.高效率：多工作台、快速精准温控及力控
- 3.高柔性：多吸嘴自动更换、多中转工位自由切换、多种上料方式灵活选配、轨道接驳上下料
- 4.易扩展：配合客户进行工艺探索、可定制开发、功能模块可选配Flip Chip

| | |
|--------------------|---|
| 产品型号 | EH9721 |
| Product model | EH9721 |
| 贴装精度 | ±2m@3 |
| Placement Accuracy | ±2m@3 |
| 贴装角度 | ±0.3° |
| Placement Angle | ±0.3° |
| 贴装工艺 | 共晶、蘸胶、Flip Chip（选配） |
| Placement Process | Eutectic, Underfill, Flip Chip (optional) |
| 设备应用 | |